# **SM16511PB**

#### 特性说明

- ◆ OUTR/G/B 默认电流 17mA
- ◆ 软件设置上电默认显示状态(不亮灯、50%白光、 100%白光、50%蓝光)
- ◆ 数据总线写地址,控制器至第一灯点只需接数据 线,无需接地址线
- ◆ 写地址成功后亮绿灯,可在线退出写地址状态, 灯具无需重新上电
- ◆ OUTR/G/B 输出端口耐压 26V
- ◆ 内置电源稳压电路,外部电源范围: 5V~24V
- ◆ 灰度等级: 256 级
- ◆ 兼容并扩展 DMX512(1990)协议信号
- ◆ 信号传输速率: 250kbps~750kbps
- ◆ 内置 EEPROM,最大支持 4096 通道寻址
- ◆ 信号传输方式:单线并联
- ◆ 封装形式: SOP8

## 应用领域

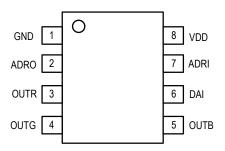
- ◆ 室内 LED 装饰照明
- ◆ 建筑 LED 外观/情景照明
- ◆ 洗墙灯、窗帘屏
- ◆ 穿孔字、护栏管

#### 概述

SM16511PB是并联应用单线传输三通道LED驱动输 出控制专用芯片,兼容并扩展DMX512(1990)信号协 议。

芯片內含电源稳压电路,时基电路,信号解码模块,数据缓存器,内置振荡器,三通道恒流驱动器默认输出电流17mA。每一输出通道皆可输出8位(256级)灰阶的可调线性电流。数据总线一次性自动写地址,支持写地址后在线退出,无需重新上电。内置EEPROM存放芯片地址。

#### 管脚定义



SM16511PB(SOP8)

\* NC 管脚必须悬空,用户 不可接 GND 或者 VDD



# 管脚定义说明

符号	管脚名称	引脚编号	说明		
DAI	数据输入+	6	DMX512 数据输入+		
VDD	芯片电源	8	电源端,内置 5V 稳压电路		
ADRI	地址输入	7	写地址输入,内置上拉电阻		
ADRO	地址输出	2	写地址输出		
OUTR/G/B	驱动输出	3~5	LED 驱动开漏输出		
GND	芯片地	1	接地端		

# 订购信息

江阳和巳	封装形式	包装	<b>麦方式</b>	卷盘尺寸
订购型号	到表形式	管装	编带	<b>仓</b>
SM16511PB SOP8		100 只/管	4000 只/盘	13寸

# 电气参数

极限参数(Ta = 25℃)

参数	符号	范围	单位
逻辑电源电压	VDD	-0.5——+5.5	V
OUTR/G/B 输出端口耐压	Vout	30	V
逻辑输入电压	V <sub>I1</sub>	-0.5——VDD+0.5	V
LED 驱动输出电流	I <sub>OL1</sub>	17	mA
功率损耗	PD	<250	mW
工作温度	T <sub>OPT</sub>	-40——+125	$^{\circ}$
储存温度	T <sub>STG</sub>	-65——+150	$^{\circ}$
ESD	Vesd	>2K	V

#### 电气特性 (Ta = 25℃)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
外部输入电压	VCC	VDD 串接电阻至 VCC	5	_	24	V
LED 扫描频率	F <sub>PWM</sub>	VDD=5.0V,OUT 端口串接 120Ω 至 5V	_	3.3K	_	HZ
OUTR/G/B 输出电流	Іоит	VDD = 5.0V	_	17	_	mA
Vour 拐点电压	Vouт	I <sub>OUT</sub> =17mA		0.7		V
DAI 端口翻转电压	V <sub>IH</sub>	VDD = 5.0V	3.3	_	_	V
	V <sub>IL</sub>	VDD = 5.0V	_	_	1.7	V
ADRO 端口驱动	Гон	ADRO 最大输出电流	-50	_	-65	mA
ADRO #m [1] JEAN	l <sub>OL</sub>	ADRO 最大灌电流	50	_	55	mA
静态电流	I <sub>DD</sub>	VDD = 5.0V	_	3.6	_	mA
OUTR/G/B 端口漏电流	lleak	VDD = 5.0V, VDS=26V	_	_	1	uA

## 恒流参数设定

芯片三个输出通道 OUTR/G/B 默认输出恒流 17mA 电流, 输出电流 lour 与 OUTR/G/B 端口电压 Vps 的关系如下表所示:

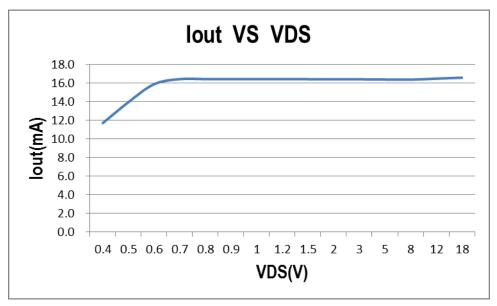


图 1 SM16511PB 输出电流 lout 与 V<sub>DS</sub> 的关系图

## 数据通信协议

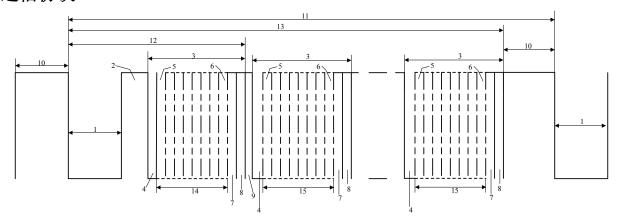


图 2 DMX512(1990)数据通信协议图

#### Figuer Key

- 1- "SPACE" for BREAK
- 2- "MARK" After BREAK (MAB)
- 3- Slot Time
- 4- START Bit
- 5- LEAST SIGNIFICANT Data BIT
- 6- MOST SIGNIFICANT Data BIT
- 7- STOP Bit
- 8- STOP Bit
- 9- "MARK" Time Between slots
- 10- "MARK" Before BREAK (MBB)
- 11- BREAK to BREAK Time
- 12- RESET Sequence (BREAK, MAB, START Code)
- 13- DMX512 Packet
- 14- START CODE (Slot 0 Data)
- 15- SLOT 1 DATA
- 16- SLOT nnn DATA (Maximun 512)

Designation	Description	Min	Typical	Max	Unit
-	Bit Rate	245	250	255	kbit/s
-	Bit Time	3.92	4	4.08	us
-	Minimum Update Time for 513 slots	-	22.7	-	ms
-	Maximum Update Rate for 513 slots	-	44	-	/s
1	"SPACE" for BREAK	88	-	-	us
2	"MARK" After BREAK (MAB)	8	-		us
_				<1.00	S
9	"MARK" Time Between slots	0	-	<1.00	s
10	"MARK" Before BREAK (MBB)	0	-	<1.00	s
11	BREAK to BREAK Time	1196	-		us
	DREAK TIME			1.00	s
12	DMX512 Packet	1196	-		us
13	DIVIAGIZ Packet			1.00	s

以上数据格式完全兼容 DMX512 (1990)

# 业务电话: 400-033-6518

#### 典型应用

该产品用于单线并联传输方式,采用国际 DMX512(1990)协议,最大并联芯片数为 1024 颗。

在显示控制及写地址时,控制器到第一个灯点无需连接地址线,而只需两根线(即 GND、DAT)就可完成写地址及显示控制,省掉了地址线,大大了提高了工程安装的灵活性及便捷性。

1、SM16511PB RGB 方案典型应用电路图

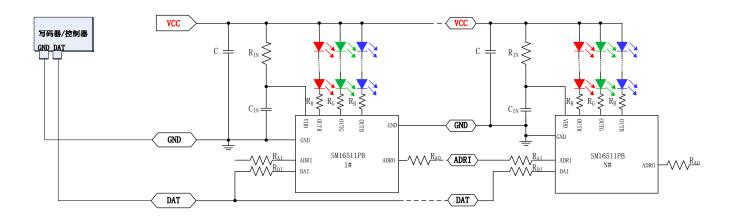


图 3 SM16511PB RGB 方案典型应用电路图

SM16511PB 典型应用电路参数包含电源输入电压 VCC,限流电阻  $R_{IN}$ ,芯片 VDD 稳压电容  $C_{IN}$  和 R/G/B LED 限流电阻  $R_{R}$ 、 $R_{G}$ 、 $R_{B}$ ,地址信号输入保护电阻  $R_{AI}$  以及地址信号输出保护电阻  $R_{AO}$ ,DAI 信号串接电阻  $R_{DI}$ 

(1) VCC 为输入电源电压, R<sub>IN</sub> 为稳压限流电阻,用于限定芯片的稳压功能开启时,内部稳压电路的工作电流; 芯片电源电压 V<sub>DD</sub>: V<sub>DD</sub>=VCC-(I<sub>DD</sub>+I<sub>IN</sub>)\*R<sub>IN</sub>

其中 I<sub>IN</sub> 是芯片内部稳压电路的工作电流,I<sub>DD</sub> 是芯片静态电流(稳压电路电流除外), R<sub>IN</sub> 阻值必须保证 V<sub>DD</sub> >3V。R<sub>IN</sub> 电阻越大,系统功耗越低,但系统抗干扰能力弱;R<sub>IN</sub> 电阻越小,系统功耗越大,工作温度较高,设计时需根据系统应用环境合理选择电阻 R<sub>IN</sub>。不同的输入电源电压 VCC,限流电阻 R<sub>IN</sub>的设计参考值如下表:

VCC (V)	5	6	9	12	15	18	24
R <sub>IN</sub> (Ω)	33	100	470	1K	1.5K	2K	3K

- (2) C 为系统电源对地的电容,用于减小电源波动,可根据系统实际负载情况选择 0.1uF-10uF 电容:
- (3) C<sub>IN</sub> 为芯片滤波电容,用于稳定芯片的 VDD 电压,保证芯片正常工作,C<sub>IN</sub> 建议取值为 100nF 电容;
- (4) R<sub>AI</sub> 为地址信号输入端口保护电阻,防止带电热拔插、电源正负极与信号线反接等情况造成信号输入端口损坏:
- (5) R<sub>AO</sub> 为地址信号输出端口保护电阻,防止带电热拔插、电源正负极与信号线反接等情况造成信号输出端口损坏;
  - (6) R<sub>R</sub>、R<sub>G</sub>、R<sub>B</sub>分别为 OUTR/G/B 端口的分压电阻,用于减小 OUTR/G/B 端口电压,降低芯片功耗,

其计算公式为
$$R_{R}/R_{G}/R_{B} = \frac{VCC - N * V_{LED} - V_{DS}}{I_{LED}}$$
,其中 VCC 是输入电压, VLED 是 LED 灯的压降,ILED 是

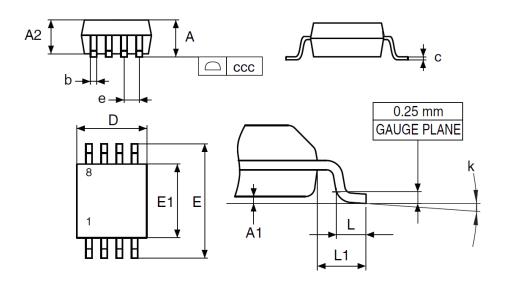
端口输出电流,V<sub>DS</sub> 是 OUTR/G/B 端口电压,达到 1V 时 OUTR/G/B 电流可恒定输出,考虑到实际应用中电压的衰减,设计时应酌情考虑 OUTR/G/B 端口的电压,以保证端口恒流输出,建议 OUTR/G/B 端口电压 V<sub>DS</sub> 设计为 3.0V 左右,具体以实际应用为准;不同颜色灯珠压降 V<sub>LED</sub> 参考值如下:红灯压降约为 2.0-2.2V,绿灯压降约为 3.0-3.2V,蓝灯压降约为 3.0-3.2V,

#### 在典型的应用中,根据不同的输入电压,不同的灯珠数量,对应的各参数建议取值如下表:

VCC(V)	OUTR/G/B 端口 串接 LED 数(颗)	R <sub>IN</sub> (Ω)	C <sub>IN</sub> (nF)	R <sub>DI</sub> (Ω)	R <sub>AI</sub> (Ω)	R <sub>AO</sub> (Ω)	$R_R(\Omega)$	$R_G(\Omega)$	$R_B(\Omega)$
12	3	1K	100	10K	510	510	150	不加	不加
24	6	3K	100	10K	510	510	510	150	150

# 封装形式

SOP8



DEMENSIONS									
REF.		mm			inch				
KEF.	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.			
А			1.75			0.0689			
A1	0.1		0.25	0.0039		0.0098			
A2	1.25			0.0492					
b	0.28		0.48	0.011		0.0189			
С	0.17		0.23	0.0067		0.0091			
ccc			0.1			0.0039			
D	4.8	4.9	5	0.189	0.1929	0.1969			
E	5.8	6	6.2	0.2283	0.2362	0.2411			
E1	3.8	3.9	4	0.1496	0.1535	0.1575			
е		1.27			0.05				
h	0.25		0.5	0.0098		0.0197			
k	0		8	0		8			
L	0.4		1.27	0.0157		0.05			
L1		1.04			0.0409				

# 业务电话: 400-033-6518